

2024-2030年中国半导体设备市场深度分析与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国半导体设备市场深度分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/416399.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体设备市场深度分析与市场年度调研报告》共五章。首先介绍了半导体设备行业市场发展环境、半导体设备整体运行态势等，接着分析了半导体设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体设备市场竞争格局。随后，报告对半导体设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体设备行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体设备产业有个系统的了解或者想投资半导体设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体产业现状

1.1、半导体产业近况

2、半导体设备简介

1.3、EUV对ArF

1.4、15英寸晶圆

第二章 半导体设备产业与市场

2.1、整体半导体设备市场

2.2、晶圆厂半导体设备市场

2.3、全球半导体市场地域分布

第三章 半导体设备产业

3.1、半导体设备产业概述

3.2、半导体产业地域分布

3.2.1、中国台湾半导体设备市场与产业

3.2.2、中国大陆半导体设备市场与产业

3.3、自动测试

3.4、蚀刻

第四章 半导体设备下游市场分析

4.1、晶圆代工业

4.1.1、晶圆代工业现状

4.1.2、晶圆代工厂资本支出

4.1.3、GlobalFoundries

4.1.4、TSMC

4.1.5、联电

4.1.6、SMIC

4.2、内存产业

4.2.1、NAND产业现状

4.2.2、东芝

4.2.4、DRAM产业现状

4.2.5、HYNIX与三星制程进度

4.2.6、DRAM厂家支出

4.3、IDM

4.4、封测产业

第五章 半导体设备厂家研究()

5.1、应用材料 (Applied Materials)

5.2、ASML

5.3、KLA-Tencor

5.4、日立高科

5.5、TEL

5.6、NIKON

5.7、DNS

5.8、AIXTRON

5.9、ADVANTEST

5.10、LamResearch

5.11、Zeiss SMT

5.12、Teradyne

5.13、Novellus

5.14、Verigy

5.15、Varian

5.16、日立国际电气

5.17、ASM国际

5.18、佳能()

部分

图表目录：

图表2024-2030年全球半导体设备市场规模

图表2024-2030年全球半导体设备资本支出统计及预测

图表2024-2030年全球半导体材料收入统计及预测

图表2024-2030年全球晶圆厂建设投入统计及预测

图表2024-2030年全球晶圆厂设备投入统计及预测

图表2024-2030年全球晶圆厂投入统计及预测

图表2024-2030年全球折合8英寸晶圆产能下游产品类型分布

图表2024-2030年全球晶圆厂产能分布统计及预测

图表2020年全球半导体设备市场地域分布

图表2024-2030年全球半导体市场地域分布预测

图表2024-2030年全球半导体设备市场技术分布

图表2024-2030年全球半导体市场下游应用分布

图表2024-2030年全球晶圆厂材料市场规模与地域分布

图表2024-2030年全球封装厂材料市场规模与地域分布

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/416399.html>